

2009年11月11日

日本電子材料株式会社

2009年度 中間決算説明会

将来の見通しに関する記述についての注意

本資料で記述されている業績予想および将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来の見通しとは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。



中間期の概要

下期の取り組み

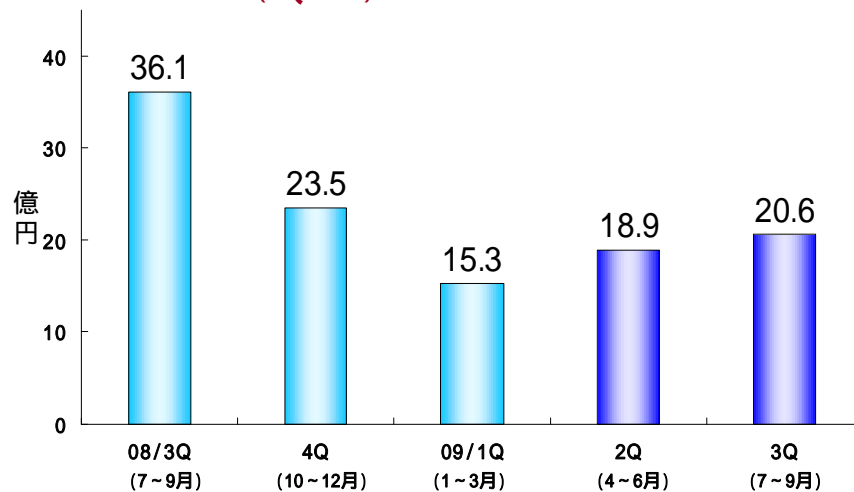
Your Probing Partner

2

事業の状況



売上推移 (Q別) (連結)



Your Probing Partner

3

上期の成果



- ロジック製品の売上確保
- 海外子会社の業績の回復
- MCの量産開始
- T社との共同開発

Your Probing Partner

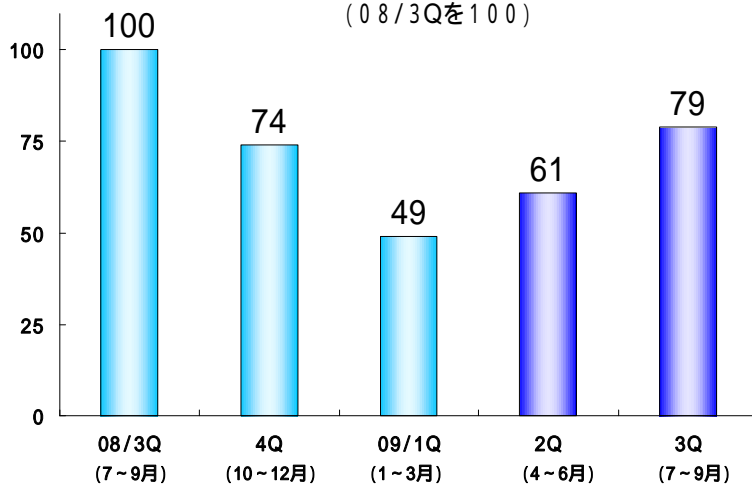
4

上期の成果



ロジック製品の売上確保 (単体)

(08/3Qを100)



Your Probing Partner

5

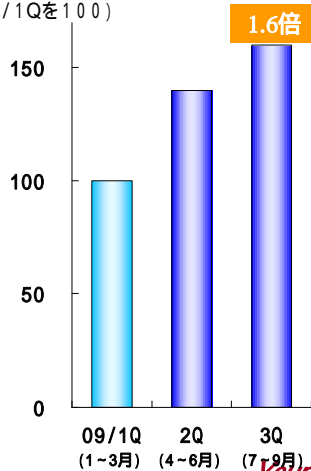
上期の成果



海外子会社の回復

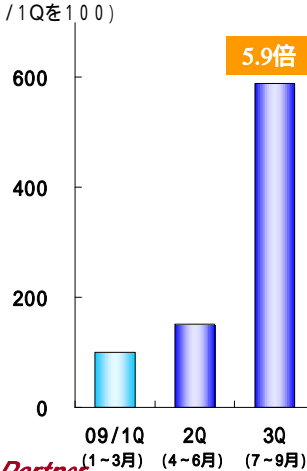
JEMアメリカ / 売上

(09/1Qを100)



JEM台湾 / 売上

(09/1Qを100)



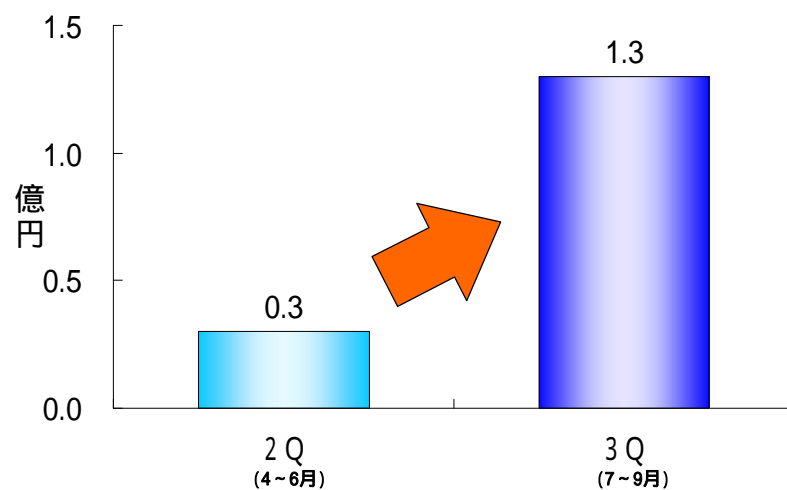
Your Probing Partner

6

上期の成果



MCの量産開始



Your Probing Partner

7

上期の成果 T社との共同開発



共同開発の背景と目的

デバイスの回路微細化への対応、更なる検査効率の向上、テストコストの削減等の顧客ニーズに応じていくためには、両社の連携が重要であるとの認識で東京エレクトロン株式会社と一致し、メモリー半導体向けの次世代プローブカードについて、共同開発に取り組むことといたしました。

～9月17日リリース文書より抜粋～

Your Probing Partner

8

上期の成果 T社との共同開発



半導体検査用

次世代型を共同開発へ

日本電子材料 東京エレクトロと連携

半導体検査用品「プローブカード」大手の日本電子材料（同神戸市）は、半導体検査装置で国内最大手の東京エレクトロ（同東京）との間で、互いに半導体向けの次世代「プローブカード」を共同開発する。発表された。互いの研究成果を結び合わせることで、半導体の検査精度を向上して検査コストの削減を目指す。

（股 貴則）

半導体の種類ごと「板」下は、半導体検査装置「板」シリコンエタハ上計、製造する「プローブ」に結びつけられ、深い基にある数百個の半導体回路の電気特性を測定する。

（C）の連電圧電流的検査をまたむに促され、

デジタル機器の小型化で高機能化、電力消費量の低減のため、半導体の微細化が進む。検査精度も高機能化や効率の向上が求められる。日本電子材料は「プローブカード」の共同開発を進め、検査装置と連携して、半導体検査用品の共同開発を進めていく。関係は、今後、両社間で進む。

09年9月18日神戸新聞 9

Your Probing Partner

2009年度中間期 連結業績



単位：億円

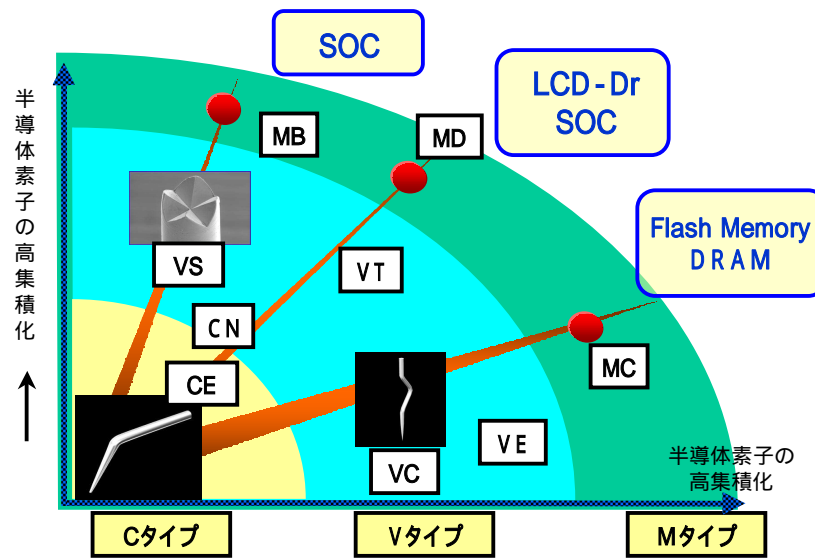
	2008年度 中間期実績	2009年度 中間期実績
売上高	69.7	39.5
営業利益	1.1	6.7
率%	1.6	
経常利益	1.2	7.2
率%	1.8	
当期純利益	0.9	7.5
率%	1.3	

Your Probing Partner

10

中間期の概要 下期の取り組み

製品ラインナップ



下期の取り組み



1. Vタイプの拡販
2. MCの安定的売上確保と原低推進
3. Cタイプの更なる市場拡大

Your Probing Partner

13

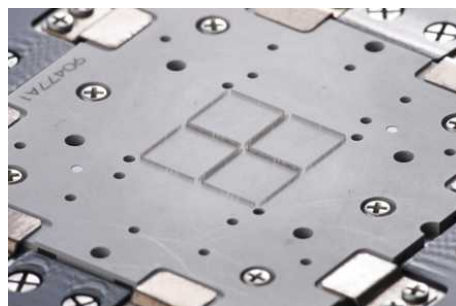
Vタイプの拡販



VTの量産拡販

《SOC向け 狭ピッチ 多数個同時測定用》

1. 高位置精度
2. 電氣的優位性
 - ・基板にMEMS技術活用
3. ピン単位交換可能
 - ・業界初



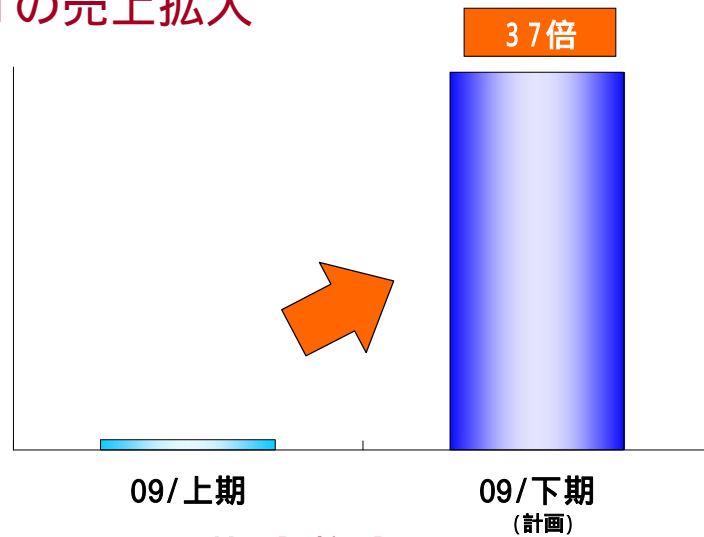
Your Probing Partner

14

Vタイプの拡販



VTの売上拡大



Your Probing Partner

15

Vタイプの拡販



VC掘り起こし

- ・海外メーカーへの積極販売
- ・特定用途メモリへの販売強化
- ・ロジック市場への投入

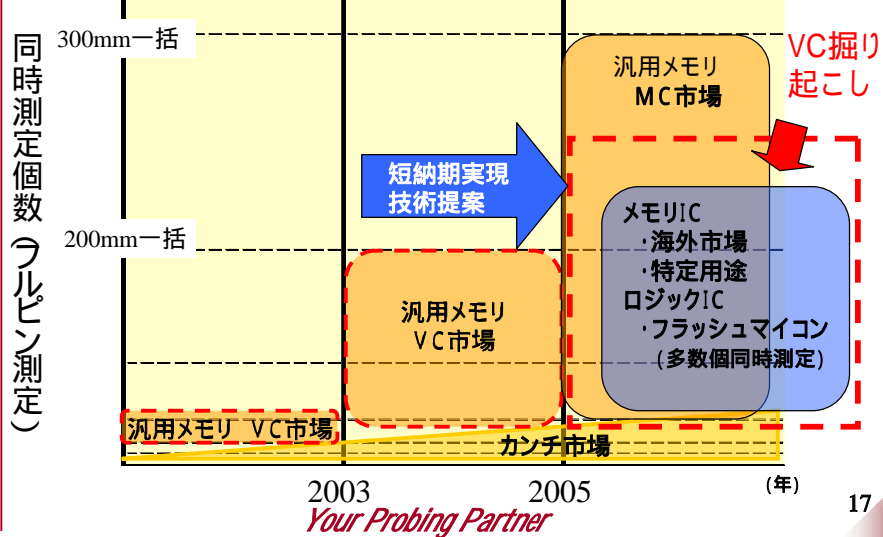
Your Probing Partner

16

Vタイプの拡販



VCの市場掘り起こし



Vタイプの拡販



VS2の拡販 (ロジック)

-SOC (フリップチップ) 向け スプリングピンタイプ-

- ・国内顧客へのサポート維持強化
- ・海外顧客へのプロモーション積極推進
- ・VS2の特徴・優位点の更なるアピール
- ・原価低減推進による価格競争力を向上

Your Probing Partner

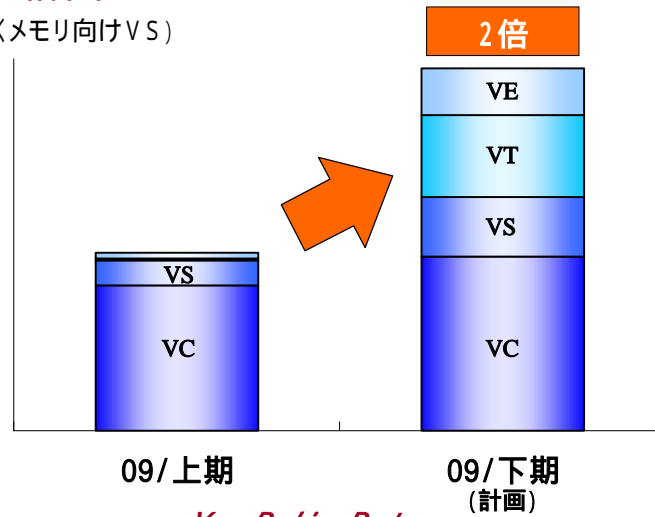
18

Vタイプの拡販



売上計画

(除くメモリ向けVS)



Your Probing Partner

19

MCの安定的売上確保と原低推進



MCの競争力強化

- ・量産ラインの堅実な拡大
- ・FLASH低コスト版の量産化
- ・DRAM、300mmサンプル投入

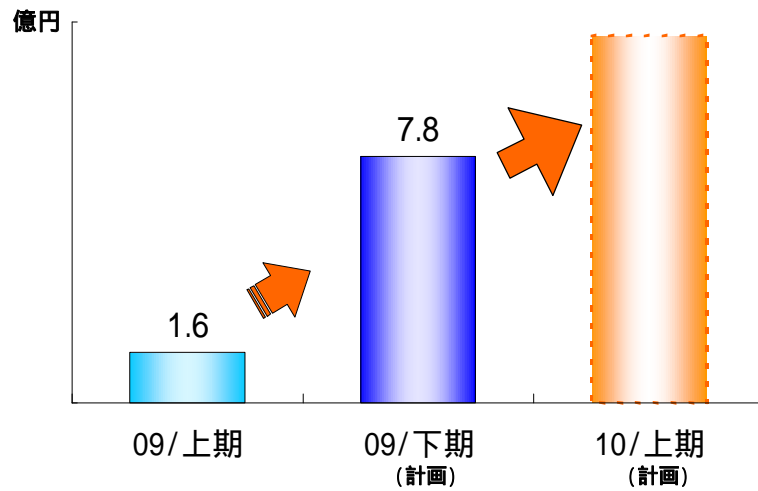
Your Probing Partner

20

MCの安定的売上確保と原低推進



MCの安定的受注確保



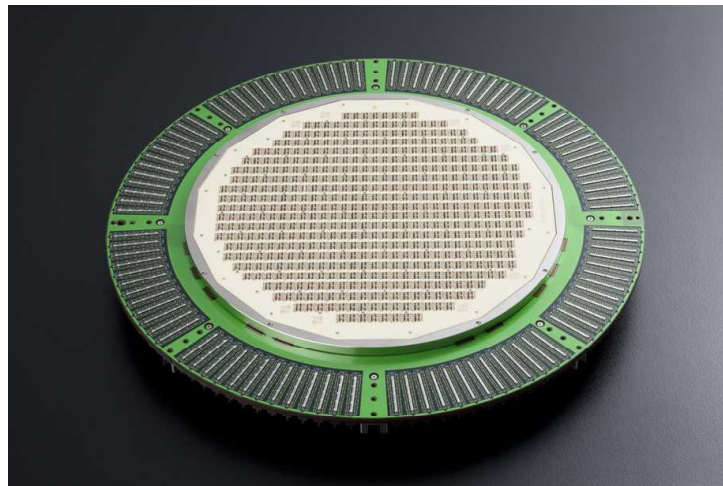
Your Probing Partner

21

MCの安定的売上確保と原低推進



MCの安定的受注確保



Your Probing Partner

22

Cタイプの更なる市場拡大



受注拡大プロジェクト継続

1. 高性能合金針の投入
2. 海外工場の徹底活用
3. 更なる生産性の向上
4. 更なるCSの向上

Your Probing Partner

23

まとめ



~ 下期黒字化をバネに
10年の飛躍に備える ~

1. Vタイプ 新たな戦力を加え拡販強化
2. Mタイプ 本格的量産の開始
3. Cタイプ 品質、CSによる市場拡大

Your Probing Partner

24

通期連結業績見通し



単位: 億円

	2008年度 実績	2009年度 予想
売上高	108.6	96.0
営業利益	10.7	6.8
経常利益	11.3	7.0
当期純利益	14.7	7.0

配当は安定配当として年間10円(中間5、期末5)を予定

Your Probing Partner

25



ありがとうございました

<http://www.jem-net.co.jp/>

Your Probing Partner

26

補足資料 決算資料

補足資料 会社概要

Your Probing Partner

27

連結貸借対照表

補足資料

単位:百万円

	2008年度末	2009年度第二四半期末
	金額	金額
資産の部		
流動資産	12,812	11,598
有形固定資産	3,196	2,988
無形固定資産	355	397
投資その他	913	876
資産合計	17,278	15,861
負債の部		
流動負債	6,183	4,612
固定負債	1,106	1,946
負債合計	7,289	6,558
純資産の部		
株主資本	10,605	9,802
評価換算差額等	-616	-499
純資産合計	9,989	9,302
負債純資産合計	17,278	15,861

Your Probing Partner

28

連結損益計算書

補足資料



単位: 百万円

	2008年度第二四半期累計	2009年度第二四半期累計
	金額	金額
売上高	6,979	3,955
売上総利益	2,054	687
販管費	1,942	1,363
営業利益又は営業損失	111	-676
営業外収益	44	57
営業外費用	28	108
経常利益又は経常損失	128	-727
特別損失	6	-
税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前四半期純損失	122	-727
法人税等合計	25	22
四半期純利益又は四半期純損失	97	-750

Your Probing Partner

29

キャッシュフロー

補足資料



単位: 百万円

	2008年度第二四半期累計	2009年度第二四半期累計
	金額	金額
営業活動によるキャッシュフロー	493	-445
投資活動によるキャッシュフロー	-916	-5,301
財務活動によるキャッシュフロー	-105	-130
現金及び現金同等物に係る換算差額	-34	29
現金及び現金同等物の増減額	-562	-5,848
現金及び現金同等物の期首残高	4,257	7,179
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,694	1,330

Your Probing Partner

30

個別、主要子会社

補足資料



単位:百万円

	2008年度中間				2009年度中間			
	売上高	営業利益	経常利益	当期純利	売上高	営業利益	経常利益	当期純利
個別	6,159	98	40	95	3,479	624	632	439
JEMアメリカ	1,159	157	173	107	510	16	27	19
JEMヨーロッパ	167	30	34	23	80	5	4	3
JEM台湾	176	104	113	109	74	61	59	56
JEM香港	670	37	39	32	291	38	36	38

Your Probing Partner

31

投資、配当

補足資料



単位:億円

	08年度	09年度	
		中間実績	通期計画
開発費	15.4	5.3	10.5
設備投資	8.0	2.5	4.0
減価償却	11.0	4.2	7.0

単位:円

	07年度	08年度	09年度(予想)
配当	年間20 中間10、期末10	年間15 中間10、期末5	年間10 中間5、(期末5)

Your Probing Partner

32

補足資料 決算資料

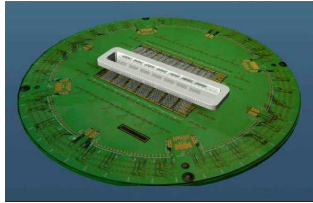
補足資料 会社概要

Your Probing Partner

33

会社概要

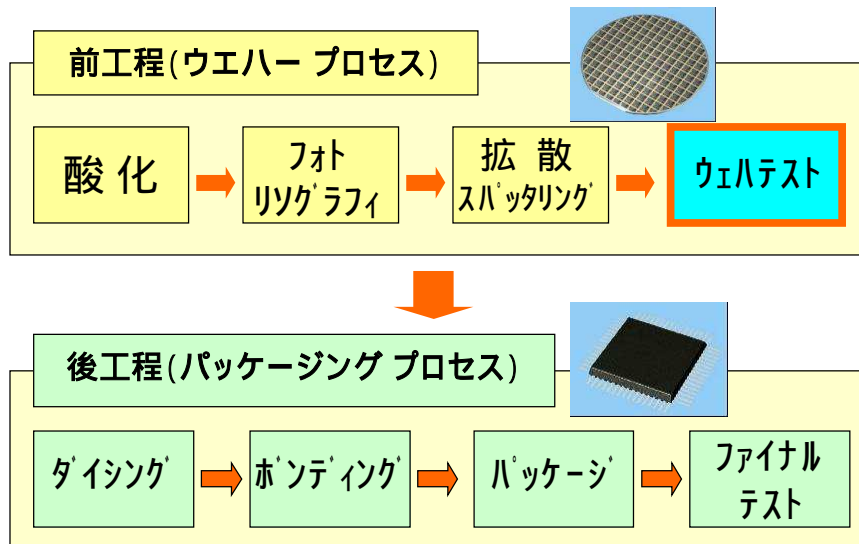
補足資料

会社名	日本電子材料株式会社 J APAN E LECTRONIC M ATERIALS CORPORATION	
設立	1960年4月	
資本金	9億8千万円	
上場	東証1部 (証券コード6855)	
子会社等	国内1 海外6	
従業員	約850名(連結)	
事業内容	半導体検査用部品(プローブカード)等 ³⁴	

Your Probing Partner

半導体の製造工程

補足資料



Your Probing Partner

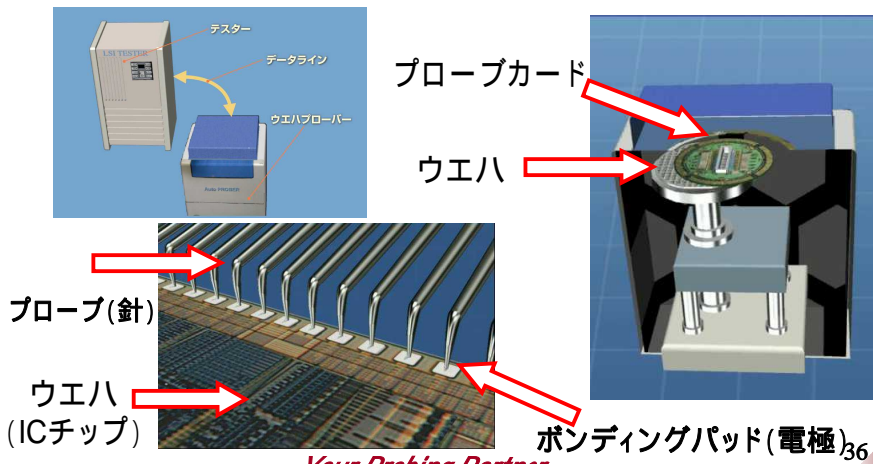
35

プローブカードとは

補足資料



半導体のウエハテスト工程で、テスターからの電気信号をICチップに伝える役割を果たし、半導体製造には必要不可欠な製品です



Your Probing Partner

36

国内拠点

補足資料



尼崎(本社)

- ・ 管理部門統括
- ・ 営業統括
- ・ 開発統括



熊本(事業所)

- ・ 生産統括
- ・ 製品設計統括
- ・ 技術統括



東京営業

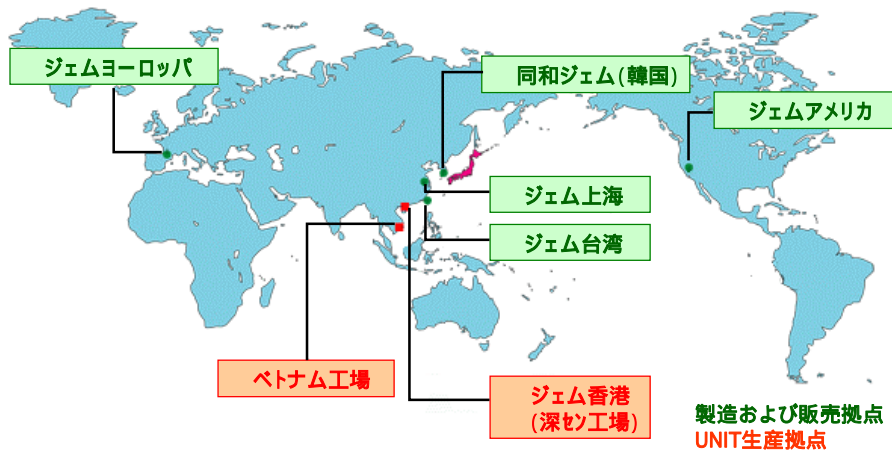
ジェムファインテック
(合併会社)

Your Probing Partner

37

海外拠点

補足資料



ジェムヨーロッパ

同和ジェム(韓国)

ジェムアメリカ

ジェム上海

ジェム台湾

ベトナム工場

ジェム香港
(深セン工場)

製造および販売拠点
UNIT生産拠点

Your Probing Partner

38

プローブカード売上高(上位5社)

補足資料



2008年 単位: \$M

Cantilever			Advanced		
1	JEM	50.8	1	FFI	210.2
2	MJC	43.1	2	MJC	144.6
3	MPI	29.6	3	JEM	79.8
4	TCL	25.9	4	Phicom	36.1
5	SV	20.0	5	TSE	26.7

(Sources: VLSI Research Report) 39

Your Probing Partner

